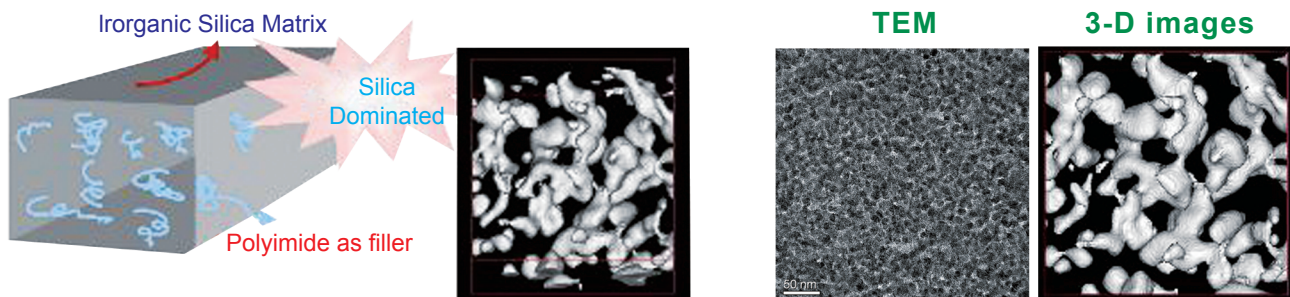


有機無機混成薄膜技術

技術特色

- ◆ 高無機含量混成技術 (>30wt%)
- ◆ 無機粒子串接技術
- ◆ R2R透明混成光學薄膜
- ◆ 具高穿透度、耐熱性、高剛性及高耐撓曲特性，可用於軟性電子產品



技術規格

厚度 (μm)	寬幅 (mm)	長度 (m)	YI	Tt (%)	bending@2mm (times)
50	1200	> 500	< 2	> 90	>200,000



產業應用

可彎曲/折疊式/捲軸式顯示器等軟性電子產品。

